

BRAZETEC AKTIVLOTE UND AKTIVLOTPASTEN















Brazing is BrazeTec 

/ BrazeTec Aktivlote

Für BrazeTec Aktivlote ist eine minimale Löttemperatur von 850 °C notwendig, um eine Verbindung mit der Keramik zu erreichen. Höhere Löttemperaturen können das Benetzungsverhalten verbessern. Als Lötatmosphären werden reines Argon (4.8) oder Vakuum (<10–3 mbar) eingesetzt.


Im Fall einer Vakuumlötung mit CB 4 oder CB 5 sollte die Löttemperatur nicht wesentlich über 900 °C bzw. bei Verwendung von CB 2 und CB 6 nicht wesentlich über 1000 °C liegen, um ein Abdampfen von Silber zu vermeiden.

Bezeichnung	Zusammensetzung in Gewicht-%				Schmelzbereich nach DSC in °C	Schmelzbereich nach ISO 17672 in °C	Löttemp. min. in °C	Dichte in g/cm ³	Besonderheiten der Anwendung	Lieferform
	Ag	Cu	In	Ti						
BrazeTec CB 2	96	-	-	4	970	-	1.000	10,3	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Graphit, Diamant, Saphir, Rubin	   
BrazeTec CB 4	70.5	26.5	-	3	780 – 820	-	850	9,9	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Graphit, Diamant, Saphir, Rubin	   
BrazeTec CB 6	98.4	-	1	0.6	950 – 960	-	1.000	10,3	Siliziumnitrid	   

/ BrazeTec Aktivlotpasten

Die BrazeTec Aktivlotpasten haben einen Metallgehalt von ca. 85 % und sind für Dispenser und Siebdruckanwendungen geeignet.

Auf Anfrage sind Legierungen mit abweichendem Titan-Gehalt lieferbar.

Bezeichnung	Zusammensetzung in Gewicht-%			Schmelzbereich nach DSC in °C	Schmelzbereich nach IS 17672 in °C	Löttemp. min. in °C	Besonderheiten der Anwendung	Lieferform
	Ag	Cu	Ti					
BrazeTec CB 10	64.8	25.2	10	780 – 805	-	850	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Graphit, Diamant, Saphir, Rubin	
BrazeTec CB 11	90	-	10	970	-	1.000	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Graphit, Diamant, Saphir, Rubin	